

株主の皆さまへ

第 33 期 報 告 書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

**TOWA**



 **TOWA株式会社**

## 株主の皆さまへ

### ご挨拶

平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災で被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、各種減税を含めた政府の経済対策や、猛暑による特需、中国をはじめとする新興国向けの輸出拡大などにより、景気は緩やかながらも回復の方向にありました。しかしながら秋以降には、経済対策に対する駆け込み需要の反動減や、引き続き厳しい雇用状況から個人消費が停滞するなど、回復の動きが一服する状態となりました。

加えて、本年3月11日に発生いたしました東日本大震災は、多くの被災者を出し、日本経済に甚大な影響を与えました。この震災の影響は今後も様々な形で現れるものと考えられ、景気動向をより不透明にすることとなりました。

このような状況のもと当社グループでは、上半期の半導体事業における受注急増局面では増産体制をとり、下期に入ってから通常の生産体制に戻すなど、目まぐるしく変化する市況に臨機応変に対応してまいりました。

また、生産や部材調達、出荷業務の海外シフトを進め、進行する円高に対応するとともに、既存各製品の原価低減にも地道に取り組むことで、収益性の伴った売上高の伸張を実現いたしました。

当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営施策の一つと考えており、各年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。この方針に基づき、当期につきましては、1株当たり10円の配当とさせていただきます。

今後とも、株主の皆さまのご期待に応えるべく、グループ一丸となって鋭意邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長

代表取締役会長

西村 永和 坂東 和彦

2011年6月

## 第33期の概況と今後の方針

半導体市場におきましては、昨年度のマイナス成長の反動に加え、多機能携帯電話やタブレット端末等の新しい電子機器が半導体需要を大きく牽引したことや、LED市場においても照明用のLEDに対する装置の需要が堅調に推移したことなどから、年度前半は非常に活況となりました。しかしながら年度後半には、製造装置への投資が一巡したことや、電子部品の在庫調整、パソコン市場の減速などがみられ、市況は足踏み状態となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は225億92百万円（前連結会計年度比83億18百万円、58.3%増）、経常利益40億64百万円（前連結会計年度は経常損失3億45百万円）、当期純利益37億51百万円（前連結会計年度は当期純損失3億30百万円）となりました。

一方、東日本大震災により多くの国内半導体メーカーが被災し、そのサプライチェーンを含めた影響は非常に大きく、半導体市場の先行きは不透明な状態にあります。当社グループでは、震災発生直後から災害対策本部を立ち上げ、社員の安否確認をはじめ、お客様の被災状況の確認とその支援体制等について迅速に対応してまいりました。幸いにも当社グループにおいては、被災した社員はなく、各事業の生産設備等にも特段の影響はありませんでしたが、今後も引き続き常に最新の情報を把握し、迅速な対応ができるよう万全を期してまいります。

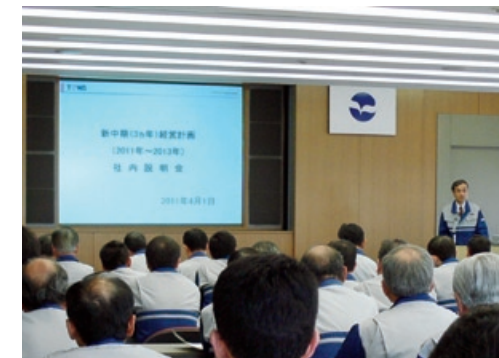
また、被災地域復興のため、微力ながら義捐金等の形で支援活動を行い、加えて、被災されたお客様に対しては、一日でも早く正常な生産活動に戻っていただけるよう、装置の再セットアップや修理、代替品の無償供給等、当社グループとして可能な限りの支援を行ってまいります。

### — 新中期経営計画 —

当社は、2014年4月に創立35周年を迎えます。これまで様々な製品・技術開発に取り組み、成果を生み出してきた結果、半導体モールドング装置においては、長年にわたり世界トップシェアを維持し、業界のリーディングカンパニーとして産業の発展に寄与してきたものと自負しております。

しかしながら現在の半導体製造技術は、その進化の速度をますます速め、求められる技術や品質水準は極めて高いものに至っております。また、競合企業の台頭や新興国をはじめとする半導体市場の拡大、用途の多様化などにより、当社グループの経営環境はさらなるグローバル化とスピードアップ、そして限界への挑戦とも言える“技術の高度化”が求められております。

以上のような認識のもと、あらためて中期的な経営の方向性を明確にするため、2011年4月からの3ヵ年を計画期間とする新中期経営計画を策定いたしました。



## 成長を続ける企業となるために

### 独自化と差別化、そして“身軽”であること

#### — 中期経営計画（2011/4～2014/3） —

新中期経営計画では、中期経営指針を「成長を続ける企業となるために必要な“仕組み”を構築する」と定めました。当社グループは、今後も世界経済や半導体市場の変動、事業領域における競合や新たな産業・市場の勃興など、様々な変化が起こることを前提とした上で、その環境を都度克服しながら成長を続け得る企業となるために必要な仕組みを本計画期間において構築し、将来にわたり皆様から信頼と安心をいただける企業を目指してまいります。

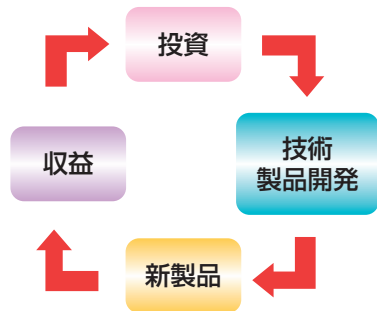
新中期経営計画の概要は以下のとおりです。

#### 《基本計画》

- ① 当社グループの強みに経営資源を集中させ、絶えず独自化と差別化の実現を図る。
- ② 効率と質の向上により経営基盤を安定させる。
- ③ 得られた収益を当社の事業領域における投資・開発に充当し、技術開発型企業の好循環を生み出す。
- ④ 人的資源の“質”の向上を図る。
- ⑤ 保有する技術・ノウハウを形（製品・サービス）にできる領域を発掘する。

当社グループは、“勝てる領域”へは積極的な投資を行いながらも、効率と質の向上による課題の解決を優先し、絶えず“身軽”であることにより変化への対応能力を強化いたします。

この“強みへの集中”と“効率と質の向上”に取り組むことで、各事業領域における独自化と差別化を実現できるものと考えております。独自化・差別化は安定した収益をもたらす、その収益をさらに“強み”に再投資することにより、あらたな技術革新を可能にし、製品の競争力を高めることで“収益の極大化”を目指します。



当社グループは、この技術開発型企業の好循環こそが、成長を続ける企業となるために必要な“仕組み”であると考えております。

#### (1) 半導体モルディング事業

ボリュームゾーンでのシェアアップを図るとともに、既に独自化・差別化を実現しているコンプレッションモールド方式の市場浸透を図り、価格や納期に留まらず、さらに“お客さまが求めるもの”を提供することで“TOWAブランド”を確立してまいります。

#### (2) LED事業

LEDの市場は今後も確実に拡大するものと思われませんが、LED照明が普及するためにはパッケージングの相当なコスト削減が必要と考えられます。

当社グループは、半導体事業で培った技術やノウハウをLED事業にも展開し、パッケージングのコスト削減を実現することで各LEDメーカーとの信頼関係を構築し、事業の拡大を図ってまいります。

	主な数値計画		
	2012年3月期 (計画)	2013年3月期 (計画)	2014年3月期 (計画)
売上高	190	220	250
半導体事業	143	163	183
LED事業	35	45	55
化成品事業	12	12	12
経常利益	12	21	29
当期純利益	11	20	28
研究開発費 (対売上高比率)	4.0 (2.1%)	4.5 (2.0%)	5.0 (2.0%)
設備投資額	13	13	13

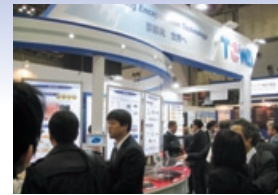
#### (3) 化成品事業

数少ない国内の成長産業といわれる「医療」分野において、各種器具に使用されるプラスチック成形品の需要は安定しております。今後もユーザーから安心していただける品質を維持し、安定した事業収益を確保してまいります。

#### (4) 新事業分野の発掘

人・社会が求めるものは絶えず変化し、製品やサービスのライフサイクルもますます短くなるものと思われれます。企業として事業活動を継続するためには、変わり続けることが必須であり、当社グループは、保有する“技術”によりあらたな市場を開拓するとともに、新技術の開発・洗練により“事業領域”を広げることに取り組んでまいります。

#### ■ 半導体パッケージング技術展／カーエレクトロニクス技術展 出展



2011年1月19日（水）から1月21日（金）までの3日間にわたり、東京ビッグサイトで開催されました「半導体パッケージング技術展／カーエレクトロニクス技術展」に出展いたしました。当社が提供する樹脂封止に関するソリューションを、半導体・LED・車載品などそれぞれの分野に活かした独自の技術力と高い生産性に対する反響は大きく、たいへん多くのお客さまにご来場いただきました。

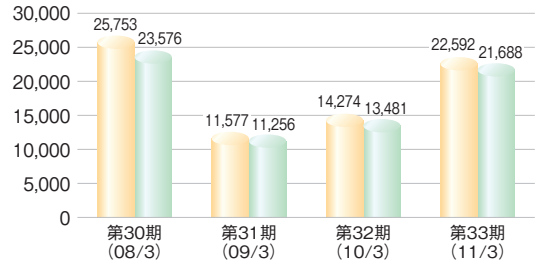
#### ■ 個人投資家向け会社説明会を開催

2010年10月、SMBC日興証券主催の個人投資家向け会社説明会を開催いたしました。当社の事業内容や企業文化を感じていただけるよう、こうした説明会やセミナーをはじめ、今後も様々な活動を展開してまいります。

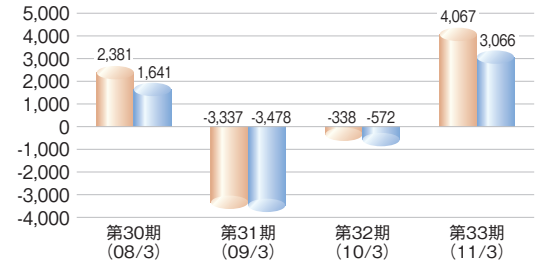
当社グループは、株主さまをはじめとするステークホルダーの方々やお客さまに一層の信頼とご満足をお願いできるよう、新中期経営計画に揚げられた諸施策を総力をあげて着実に実行してまいります。

# 業績の推移

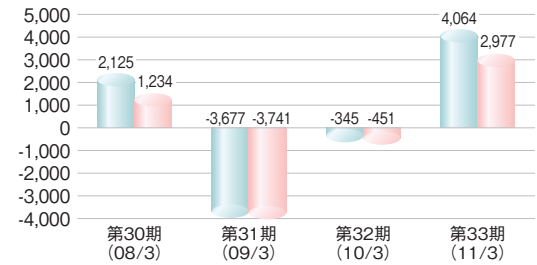
**売上高** (単位:百万円)



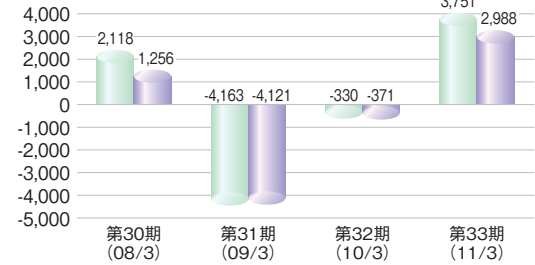
**営業利益** (単位:百万円)



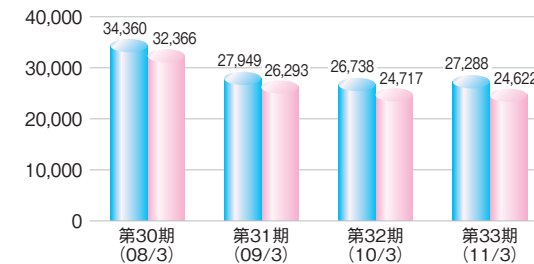
**経常利益** (単位:百万円)



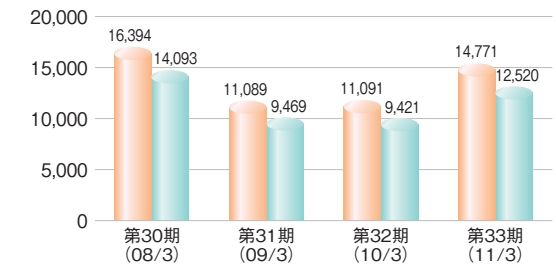
**当期純利益** (単位:百万円)



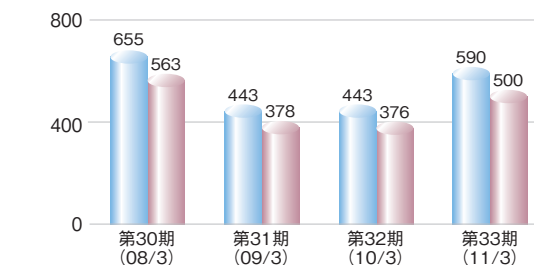
**総資産** (単位:百万円)



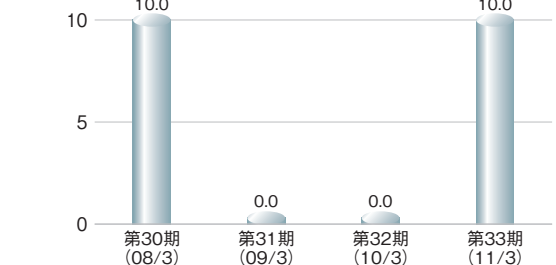
**純資産** (単位:百万円)



**1株当たり純資産額** (単位:円)

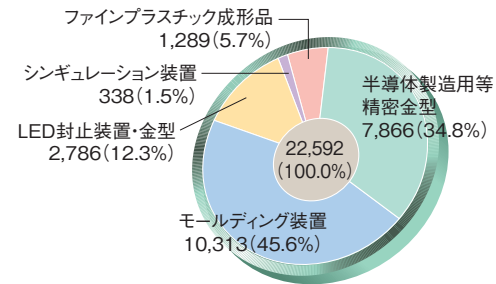


**1株当たり配当金** (単位:円)

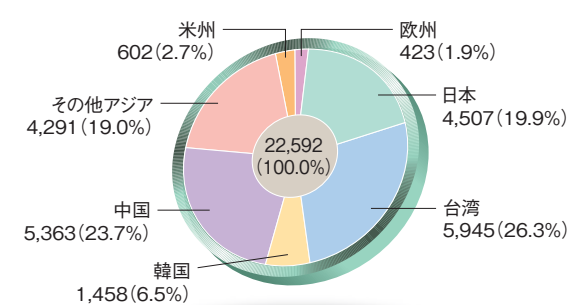


## [セグメント別連結売上高 (第33期)]

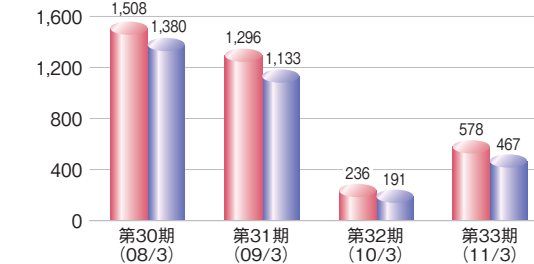
■製品別 (単位:百万円)



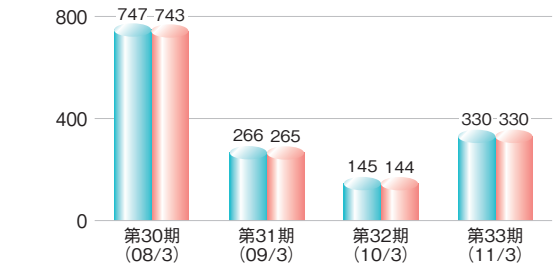
■地域別 (単位:百万円)



**設備投資** (単位:百万円)



**研究開発費** (単位:百万円)



業績の推移

## 決算概要

連結貸借対照表 (2011年3月31日現在)

科目	金額
<b>【資産の部】</b>	
流動資産	13,669
現金および預金	5,141
受取手形および売掛金	5,516
たな卸資産	2,733
その他	279
固定資産	13,619
有形固定資産	9,773
建物および構築物	3,908
土地	4,185
その他	1,680
無形固定資産	878
投資その他の資産	2,967
資産合計	27,288

(注) 当期の連結子会社は11社、持分法適用会社は4社であります。

連結損益計算書

(2010年4月1日から2011年3月31日まで) (単位：百万円)

科目	金額
売上高	22,592
売上原価	14,442
売上総利益	8,150
販売費および一般管理費	4,083
営業利益	4,067
営業外収益	315
営業外費用	319
経常利益	4,064
特別利益	16
特別損失	138
税金等調整前当期純利益	3,941
法人税、住民税および事業税	170
法人税等調整額	19
当期純利益	3,751

(単位：百万円)

科目	金額
<b>【負債および純資産の部】</b>	
流動負債	8,501
支払手形および買掛金	1,981
短期借入金	2,897
その他	3,623
固定負債	4,016
長期借入金	3,002
その他	1,014
負債合計	12,517
株主資本	14,992
資本金	8,932
資本剰余金	462
利益剰余金	5,605
自己株式	△ 8
その他の包括利益累計額	△ 221
その他有価証券評価差額金	517
為替換算調整勘定	△ 739
純資産合計	14,771
負債・純資産合計	27,288

連結キャッシュ・フロー計算書

(2010年4月1日から2011年3月31日まで) (単位：百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,571
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 620
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,808
現金および現金同等物に係る換算差額	△ 44
現金および現金同等物の増減額	1,097
現金および現金同等物の期首残高	3,836
現金および現金同等物の期末残高	4,933

連結株主資本等変動計算書 (2010年4月1日から2011年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2010年3月31日 残高	8,932	462	1,853	△ 7	11,240
連結会計年度中の変動額					
当期純利益			3,751		3,751
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	3,751	△ 0	3,751
2011年3月31日 残高	8,932	462	5,605	△ 8	14,992

	その他の包括利益累計額			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計	
2010年3月31日 残高	406	△ 555	△ 149	11,091
連結会計年度中の変動額				
当期純利益				3,751
自己株式の取得				△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	111	△ 183	△ 72	△ 72
連結会計年度中の変動額合計	111	△ 183	△ 72	3,679
2011年3月31日 残高	517	△ 739	△ 221	14,771

## 会社の概要

商号	TOWA株式会社 (英文名TOWA CORPORATION)			
設立	1979年4月17日			
資本金	8,932,627,777円			
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250 (代表)			
従業員数	438名			
役員 (2011年6月29日現在)	代表取締役会長	坂東和彦	代表取締役社長	西村永和
	専務取締役	岡田博和	常務取締役	福田誠二
	常務取締役	福富久	取締役	小西久二
	取締役	桑木一肇	執行役員	石田耕隆
	執行役員	渡邊本一	執行役員	岸本利浩
	執行役員	浦上利浩	執行役員	寺内茂司
	執行役員	宮川清公	常勤監査役	大崎山
	監査役	杉山	監査役	梅山
	監査役	梅山	監査役	梅山
ホームページ	<a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a>			
上場取引所	東京証券取引所市場第一部 大阪証券取引所市場第一部			

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	大阪市北区曾根崎二丁目11番16号 みずほ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部
郵便物の郵送先	〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部
電話お問合せ先	☎0120-288-324 (フリーダイヤル)
単元株式数	100株
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL ( <a href="http://www.towajapan.co.jp">http://www.towajapan.co.jp</a> )

## 株式の状況 (2011年3月31日現在)

- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,021,832株
- 株主数 9,897名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	3,590 <small>千株</small>	14.4%
有限会社ケイビー恒産	2,000	8.0
坂東和彦	1,545	6.2
資産管理サービス信託銀行株式会社	991	4.0
株式会社京都銀行	699	2.8
山田矩規子	514	2.1
有限会社ケイビーテクノ	500	2.0
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン エスエル オムニバス アカウント	397	1.6
メロンバンク エービーエヌ アムログローバル カストディ エヌブイ	395	1.6
坂東敬子	320	1.3

(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(9,091株)を控除して計算しております。

## TOWAグループ (2011年3月31日現在)

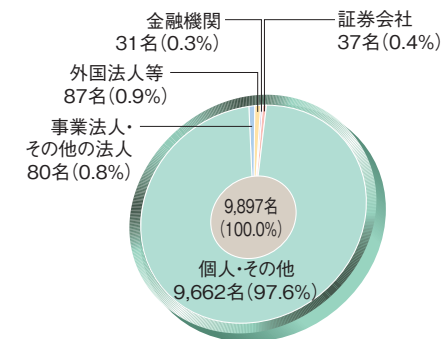
### 国内

TOWA株式会社  
本社・工場  
京都東事業所  
坂東記念研究所  
九州事業所  
東京営業所  
株式会社バンディック  
TOWATEC株式会社  
TOWAサービス株式会社  
株式会社サーク

### 海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)  
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)  
TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corporation (フィリピン)  
TOWA America Corporation (米国)  
TOWA Europe GmbH (ドイツ)  
東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)  
上海沙迪克軟件有限公司 (中国)  
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)  
蘇州STK鑄造有限公司 (中国)  
台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)  
巨東精技股份有限公司 (台湾)  
SECRON Co., Ltd. (韓国)  
株式会社東進 (韓国)

### 所有者別株主数分布



### 所有者別株式数分布

